

INVESTOR RELATIONS 2026

From Architecture to Silicon

 ADTechnology

ADTechnology는 국내 최고의 ASIC 설계 전문기업으로, 글로벌 파트너와 함께 고객 맞춤형 반도체 솔루션을 제공합니다.

# Disclaimer

본 자료는 기관투자자와 일반투자자들을 대상으로 실시되는 PRESENTATION에서의 정보제공을 목적으로 (주)에이디테크놀로지(이하 “회사”)에 의해 작성되었으며 이의 반출, 복사 또는 타인에 대한 재배포는 금지됨을 알려드리는 바입니다.

본 자료에 기재된 정보에 대해서는 별도의 독립적인 확인 과정이 이루어지지 않았습니다. 본 자료에 포함된 정보나 의견의 공정성, 정확성 또는 완결성과 관련하여, 어떠한 명시적 또는 묵시적 진술보장도 제공되지 않으며, 본 자료에 포함된 정보나 의견의 공정성, 정확성 또는 완결성에 관하여 의존하여서도 안 됩니다. 본 자료에 포함된 정보는 본 자료 제공 당시의 상황에 기초하여 해석되어야 하며, 본 자료 제공 이후 발생한 중대한 진행사항을 반영하여 업데이트 되지 않을 것입니다. 회사, 관계회사와 그 임원, 이사, 직원 또는 자문사 등 회사와 관련된 어떠한 자도 과실 등 여부를 불문하고 본 자료 또는 그 기재내용을 이용함으로써 발생하거나 또는 달리 본 자료와 관련하여 발생하는 어떠한 손해에 대해서도 여하한 책임을 부담하지 않습니다.

본 자료에 포함된 회사의 경영실적 및 재무성과와 관련된 모든 정보는 기업회계기준에 따라 작성되었습니다. 본 자료에 포함된 “예측정보”는 개별 확인 절차를 거치지 않은 정보들입니다. 이는 과거가 아닌 미래의 사건과 관계된 사항으로 회사의 향후 예상되는 경영현황 및 재무실적을 의미하고, 표현상으로는 ‘예상’, ‘전망’, ‘계획’, ‘기대’, ‘E’ 등과 같은 단어를 포함합니다.

위 “예측정보”는 향후 경영환경의 변화 등에 따라 영향을 받으며, 본질적으로 불확실성을 내포하고 있는 바, 이러한 불확실성으로 인하여 실제 미래실적은 “예측정보”에 기재되거나 암시된 내용과 중대한 차이가 발생할 수 있습니다. 또한, 향후 전망은 PRESENTATION 실시일 현재를 기준으로 작성된 것이며 현재 시장상황과 회사의 경영방향 등을 고려한 것으로 향후 시장환경의 변화와 전략수정 등에 따라 변경될 수 있으며, 별도의 고지 없이 변경될 수 있음을 양지하시기 바랍니다.

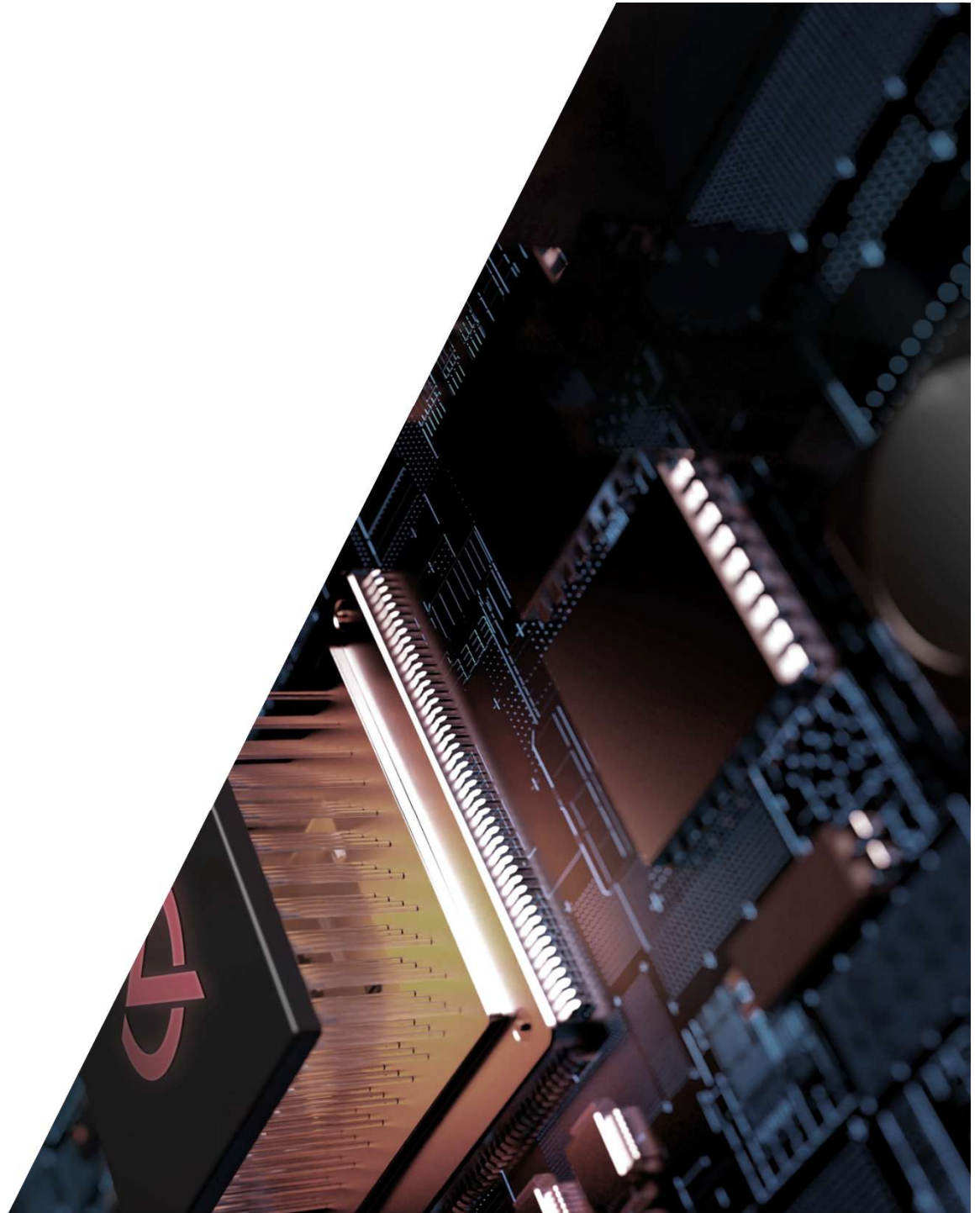
본 자료의 특정 정보(data)는 다양한 외부 출처를 통해 확보된 것으로 회사는 해당 정보에 대하여 독립적으로 출처를 검증하지 않았습니다. 따라서 회사는 해당 정보의 정확성이나 완결성에 대한 어떠한 진술도 하지 않으며, 해당 정보는 위험과 불확실성을 수반하고 다양한 요소로 인하여 변경될 수 있습니다.

본 자료의 활용으로 발생하는 손실에 대하여 회사 및 각 계열사, 자문역 또는 REPRESENTATIVE들은 그 어떠한 책임도 부담하지 않음을 알려드립니다(과실 및 기타의 경우 포함).

본 문서는 주식의 모집 또는 매매 및 청약을 위한 권유를 구성하지 아니하며 문서의 그 어느 부분도 관련 계약 및 약정 또는 투자 결정을 위한 기초 또는 근거가 될 수 없음을 알려드립니다.

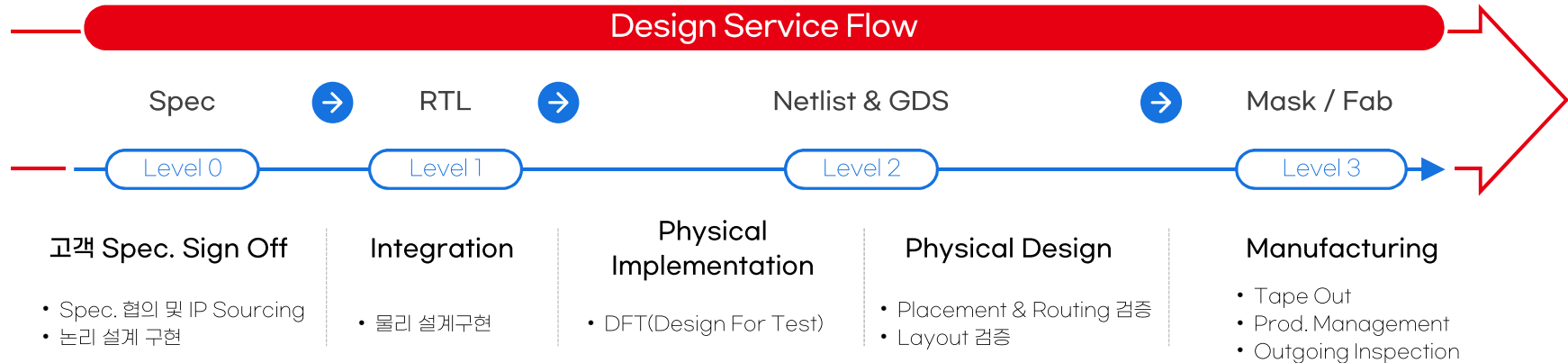
# Prologue

1. 디자인하우스란?



## 디자인하우스란?

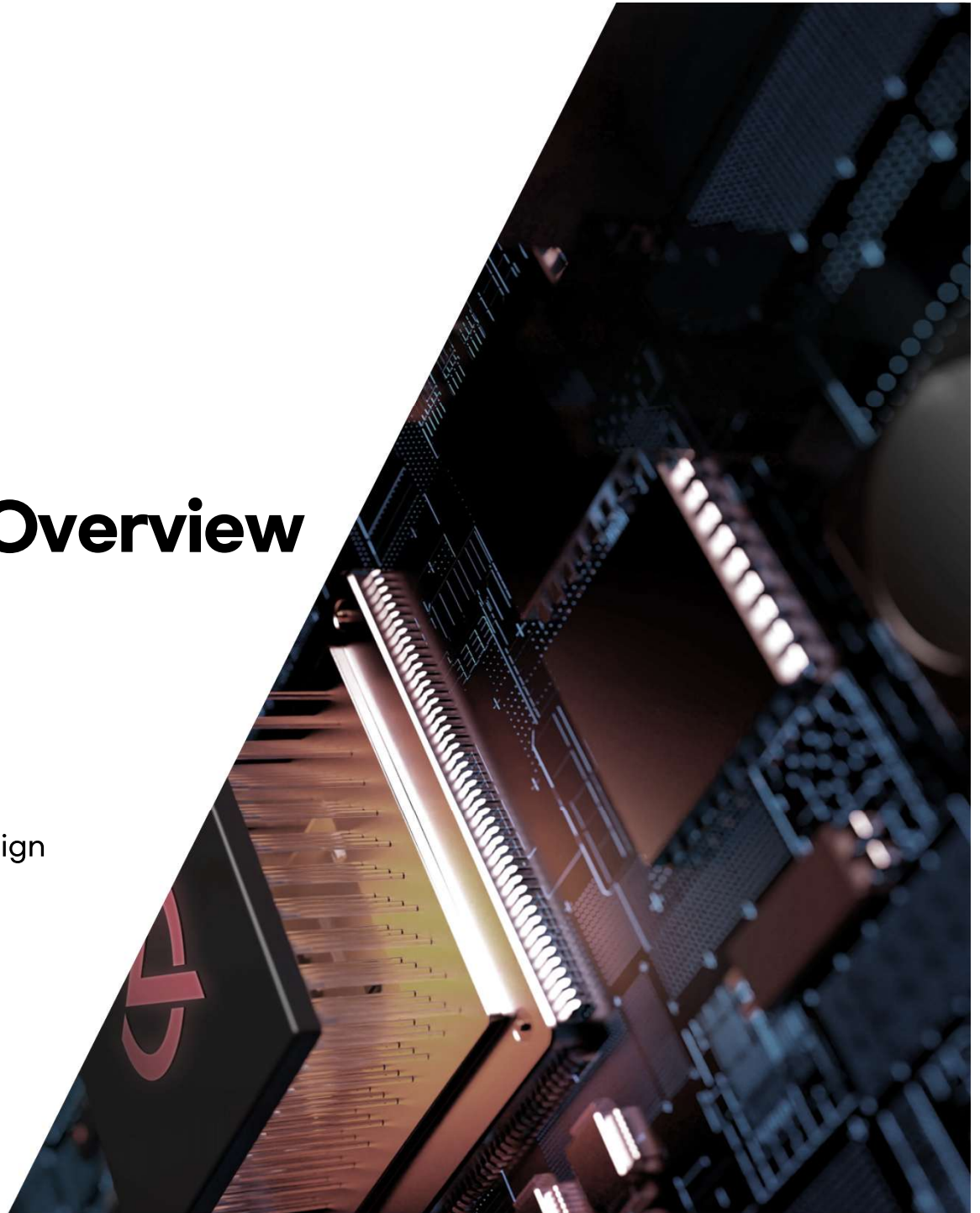
디자인하우스는 Foundry와 긴밀한 파트너십을 통해 Fabless 고객이 칩을 양산할 수 있도록 맞춤형 설계 서비스를 하는 기업



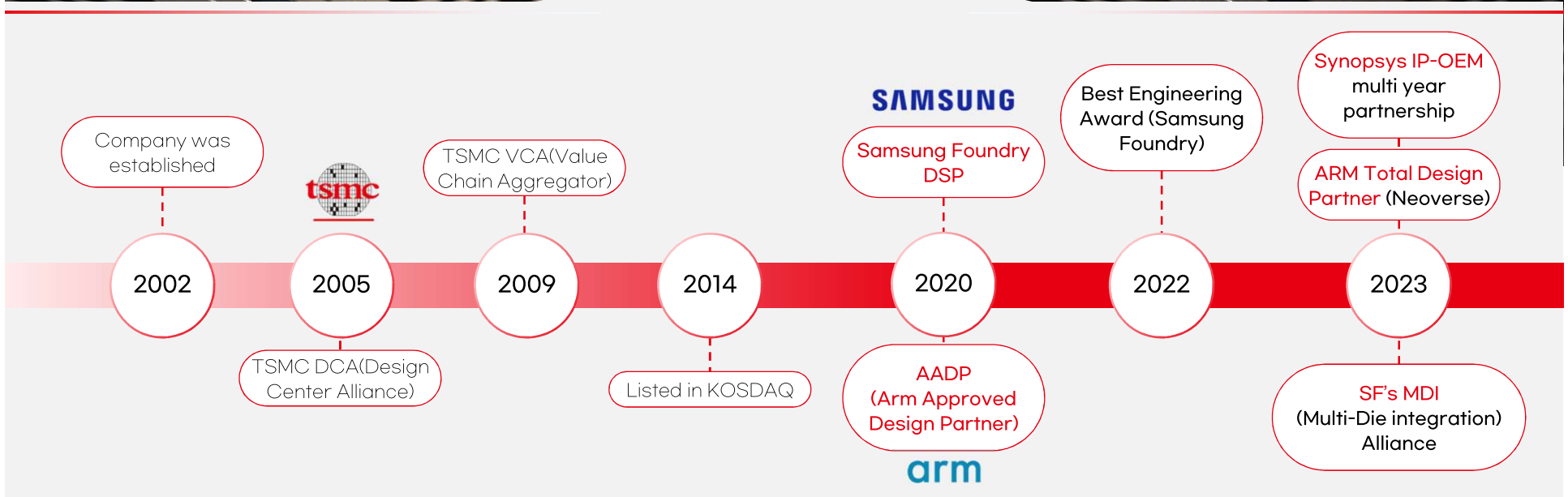
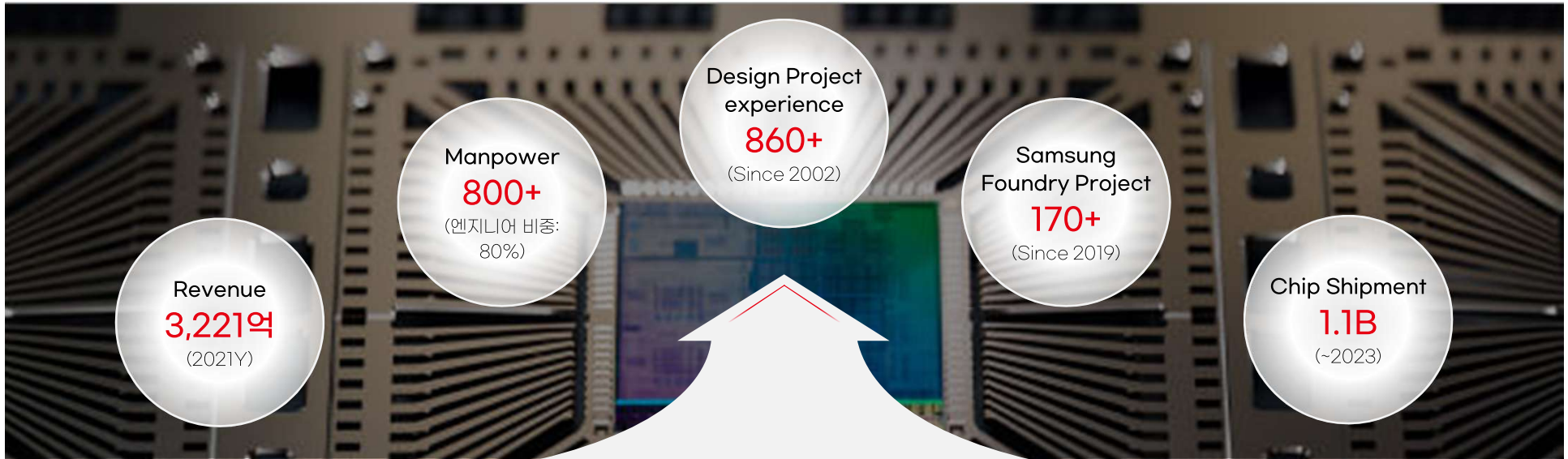
칩 개발 난이도 증가에 따라 고객사의 요구 사항이 Level 2~3에서 Level 0~1까지 확대되는 중

# ADTechnology Overview

1. About ADTechnology
2. 핵심 경쟁력 ① 폭 넓은 서비스 커버리지
3. 핵심 경쟁력 ② IP Solution
4. 핵심 경쟁력 ③ Turnkey Solution
5. 핵심 경쟁력 ④ ADP™(Advanced Design Platform)

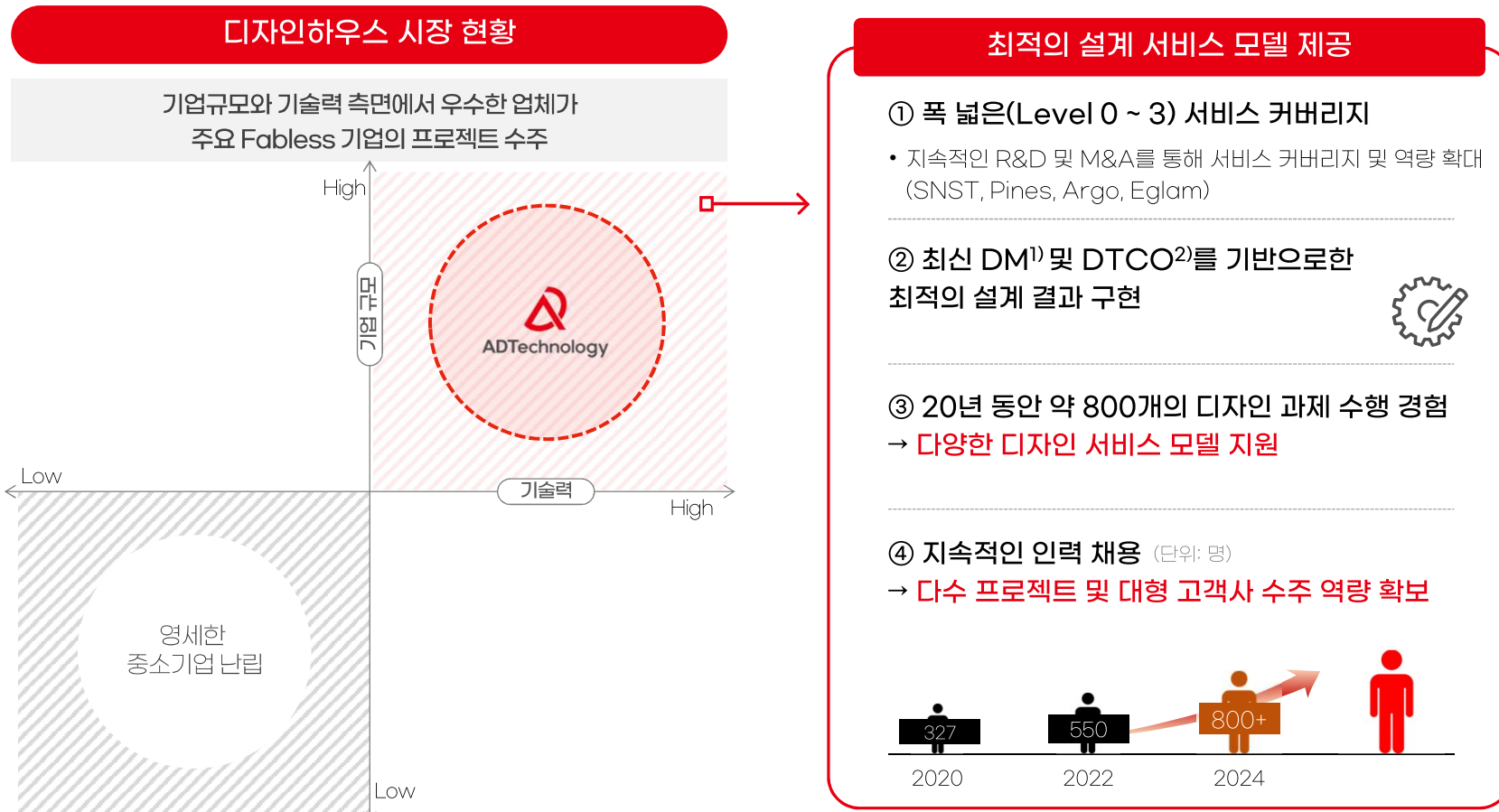


## About ADTechnology



## 핵심경쟁력 ① 폭 넓은 서비스 커버리지

폭 넓은 서비스 커버리지와 다양한 프로젝트 수행 경험을 통해 고객사에게 최적의 설계 서비스 모델 제공



1) DM(Design Methodology): 반도체 칩을 설계하고 제조하는 과정에서 사용되는 설계 방법론

2) DTCCO(Design Technology Co-Optimization): 반도체 개발 초기 단계부터 설계와 제조 공정을 동시에 고려하여 최적의 성능을 달성하는 방법론

## 핵심경쟁력 ② IP Solution

Hybrid Solutions(자체 개발 Foundation IP + Global Partner IP)를 통해 Best-in-Class PPA 구현  
 → 고객사에게 최상의 IP Solution 제공

### ADTechnology Foundation IP (In-house IP)

#### ADTechnology In-House Value-Added Foundation IP



**High Speed Serial Interface IP**  
 고속 인터페이스 기술



**Power Management**  
 저전력 & 고정밀 회로 설계 기술



**Embedded SRAM**  
 고성능 메모리 기술



**Custom Library**  
 저전력, 고속 셀 라이브러리 설계 기술

**고객 맞춤형  
 설계 서비스  
 제공**

### Partner IP (External IP)



**Foundry Partner**

Foundation IP



**IP Partner**

세계 최대 반도체 IP 기업

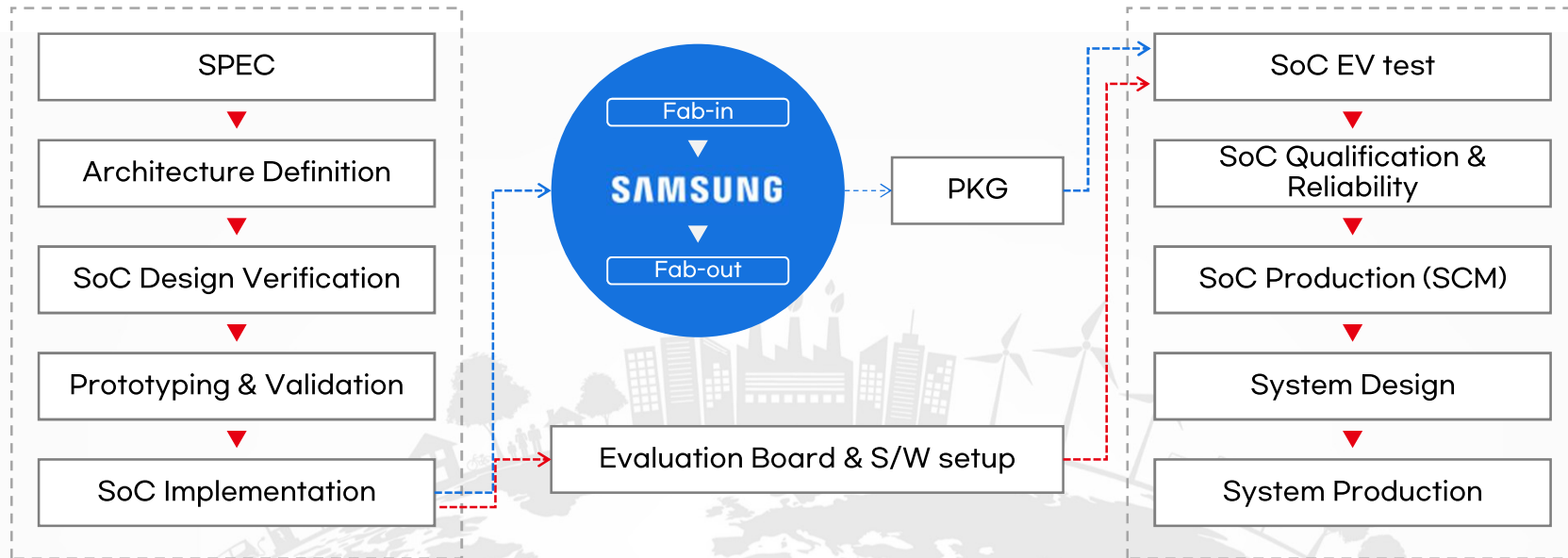


**IP Partner**

세계 최대 반도체 IP/EDA 기업

## 핵심경쟁력 ③ Turnkey Solution

연간 3.6억개 이상의 SoC(System on Chip) 양산 경험을 바탕으로 검증된 양산 노하우 보유

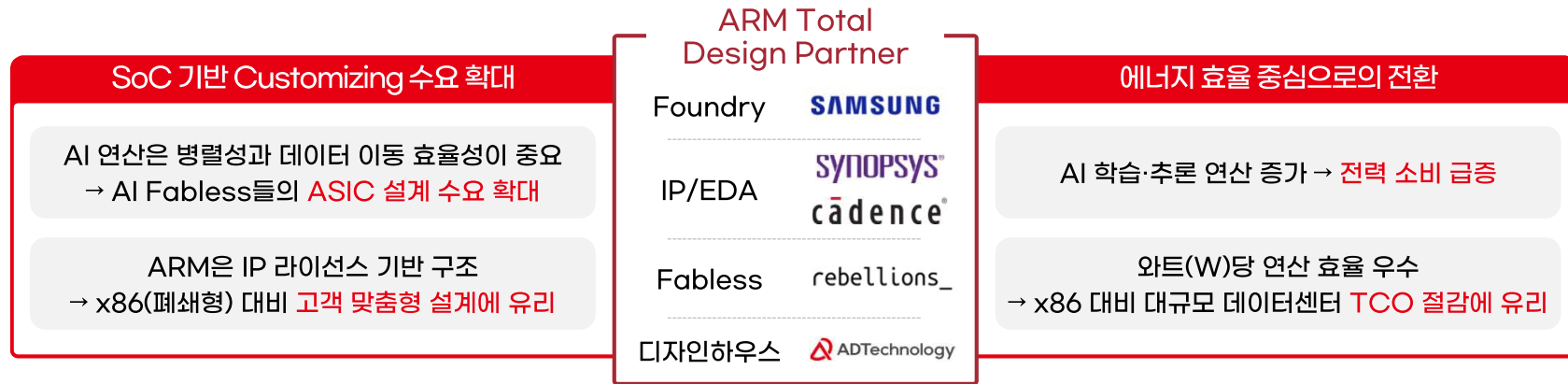


전담 SCM & Test / PKG / QA 팀 보유, 글로벌 OSAT와 파트너십 체결, 2.5D PKG 등 다양한 역량 보유



## 핵심경쟁력 ④ ADP™(Advanced Design Platform)

AI CPU 시장의 변화: Architecture 시장 내 ARM 채택률 상승



**ARM Neoverse CSS<sup>1)</sup>** CPU 설계 뼈대까지만 개발된 Platform을 고객에 라이선스해 판매하고 나머지 영역은 고객사가 Customize 할 수 있게 하는 Platform

사례 **amazon** • Graviton 4  
• Trainium 2

**Microsoft** • Maia 100  
• Cobalt 100

**NVIDIA** • Grace CPU  
• BlueField



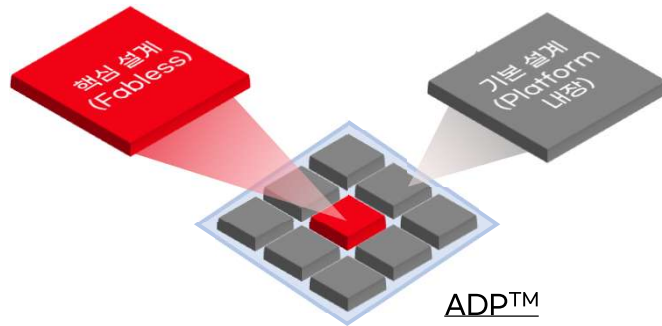
“고객사의 Customizing 수요 대응 및 Time-to-Market 단축”

1) CSS(Compute Sub Systems)

## 핵심경쟁력 ④ ADP™(Advanced Design Platform)

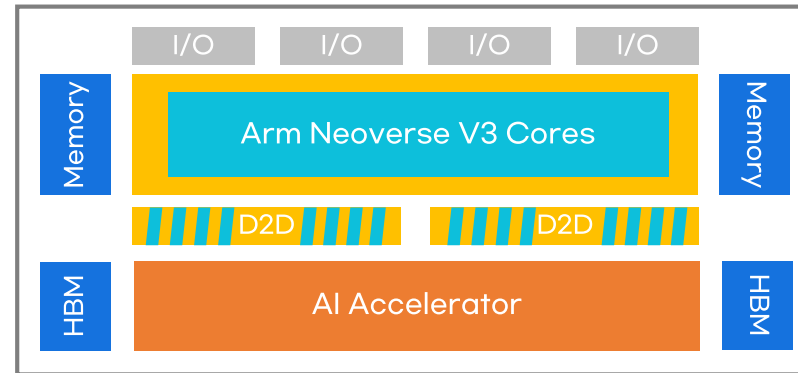
ADTechnology는 글로벌 기업들과 함께 선단 공정 기반 AI/HPC/Automotive Platform을 개발  
→ 뛰어난 반도체 설계 역량과 글로벌 시장 대응력 입증

ARM 기반 맞춤형 SoC 설계를 가능하게하는 ADP™



ADP™ (Advanced Design Platform)	
개념	CPU, 메모리, 통신용 IP 등을 통합한 SoC Platform (Level 0 ~ 0.5)
장점	<ul style="list-style-type: none"> <li>고객사는 핵심 회로설계에 집중</li> <li><b>: 제품 개발 기간 및 비용 단축</b></li> <li>칩 설계 진입장벽 ↓</li> <li><b>: Platform 기반으로 빠른 설계 착수 가능</b></li> </ul>
Application	ADP 500 Series (Automotive) ADP 600 Series (AI/HPC)

ADP 620(Neoverse Chiplet Platform)



ADTechnology — Samsung — Rebellions — Arm



### 기술 리더십 확보

Neoverse V3 + SF 2nm 공정 기반 CPU Chiplet  
국내 최초 설계·검증



### 다양한 고객 수요 확보

중소 Fabless는 물론, 국내 대기업 및 글로벌 AI 인프라  
기업까지 고객 확대 가능  
(기대 매출액<sup>1)</sup>: 약 10억불, 3Q28 ~ 4Q30)

1) 기대 매출액: ARM CPU M/S 중간값(27%) x 삼성전자 파운드리 예상 M/S(20%) x ADTechnology target M/S 10% 값

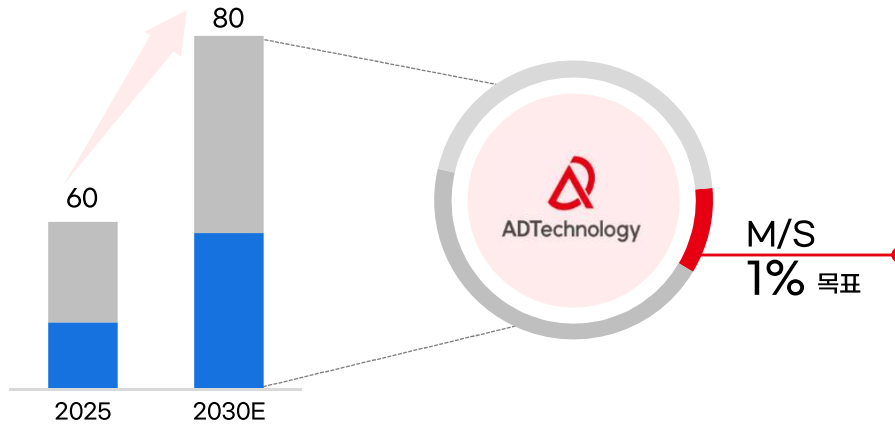
## 핵심경쟁력 ④ ADP™(Advanced Design Platform)

성장하는 Arm Architecture 시장 점유율 상승 통한 신성장동력 확보

### CPU 시장 규모<sup>1)</sup>

■ Arm Architecture 점유율

(단위: Billions USD)



### 전방 시장 기회

#### ARM CPU 자체 개발 지속

- 주요 CSP들은 약 1.5~2년 주기로 자체 개발한 Arm CPU를 출시  
→ 차차세대('27~'28년) 제품을 목표로 한 대응 전략이 필요

#### AI 추론 기업들의 등장

- NPU 등 AI 추론에 특화된 팹리스 기업이 다수 등장  
→ Neoverse와 AI 추론 프로토콜을 연결하는 인터페이스 모듈이 부재

#### 소버린 AI 중요성 대두

- AI 시장 급성장과 함께, 각국인 소버린 AI를 전략적으로 강화  
→ 인프라와 기술 내재화의 중요성이 더욱 커짐

### 사업화 방안

#### CPU Only Biz

- ADP620 CPU 다이를 단독 또는 멀티칩으로 구성 판매  
→ 기존 CPU구매 구조와 유사 Arm V3기반 고성능/고효율로 차별화

#### CPU + Chiplet Biz

- 시가속기와 결합하여 통합칩을 제공하며, 설계·검증·패키징까지 포함하는 고부가가치 서비스 모델

#### 서버칩 턴키 과제 수주 Biz

- 플랫폼 기반 커스터마이징 CPU를 턴키로 개발·양산하는 BM  
→ 고단가·장기 계약형 매출 창출 가능

국내외 팹리스

국내외 하이퍼스케일러

rebellions\_

FURIOSA

MANGOBOOST

kt

SK telecom

NAVER

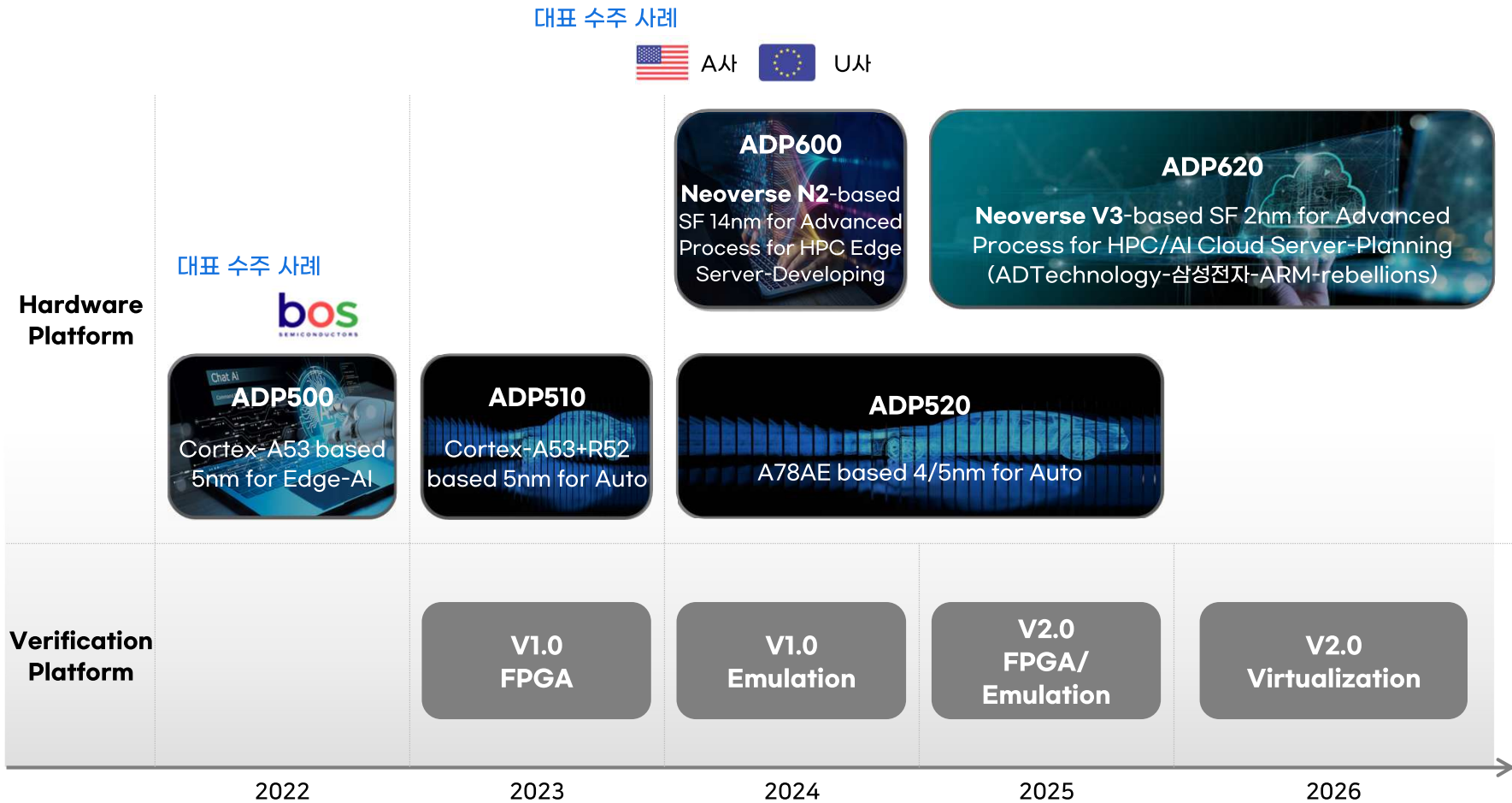
kakao

Microsoft

Google

<sup>1)</sup> 출처: Gartner, Omdia, IDC, MI

# 핵심경쟁력 ④ ADP™(Advanced Design Platform)



# Growth Strategy

1. Growth Strategy
2. 고성능 AI/HPC 반도체 핵심 설계 역량 확보
3. 해외 시장 확장



# Growth Strategy

경쟁사 대비 뛰어난 경쟁력을 바탕으로 고부가가치 턴키 프로젝트 수주 및 해외시장 확장  
(턴키 프로젝트 비중: 60%(‘24년) → 81%(‘25년) → 96%(‘26년 1분기))

## ADTechnology 경쟁력 및 성장 전략



### AI·HPC·Automotive 중심 사업 포트폴리오 구축

- 첨단 기술 기반 고부가가치 프로젝트 수주 → 수익성 증대
- 미래 성장동력 확보를 위한 지속적인 R&D 및 투자 진행

### ADP™ 기반 Turnkey Solution

- 독자적인 Platform을 활용한 기술경쟁력 확보
- 고객 개발 기간 단축과 품질 최적화를 통한 영업 경쟁력 확보

---

### 해외시장 확장 및 레퍼런스 확보

- 미국, 유럽, 중국 등 주요 글로벌 시장에 대한 시장 진출 가속화
- 글로벌 고객사와의 협력 확대를 통해 장기적 성장 기반 마련

### Turnkey 수주 비중 증가

- Turnkey 수주 비중 지속적인 확대 → 안정적인 매출 기반 마련 및 수익성 개선 기여



사업 성장에 따른 선순환 모델 구축

## 고성능 AI/HPC 반도체 핵심 설계 역량 확보

### Leading Node·Big Die·Advanced Packaging

#### Leading Node

DSP 최초 2nm 과제 수주  
(Siemens社)

#### Max Die Size

**700~800mm<sup>2</sup>**

#### Advanced Packaging

2.5D/3D  
Packaging

#### 고난이도 IP 설계 경험

HBM3E, LPDDR5  
Pcle Gen6·Ucle 등

#### 대형 SoC 프로젝트 레퍼런스

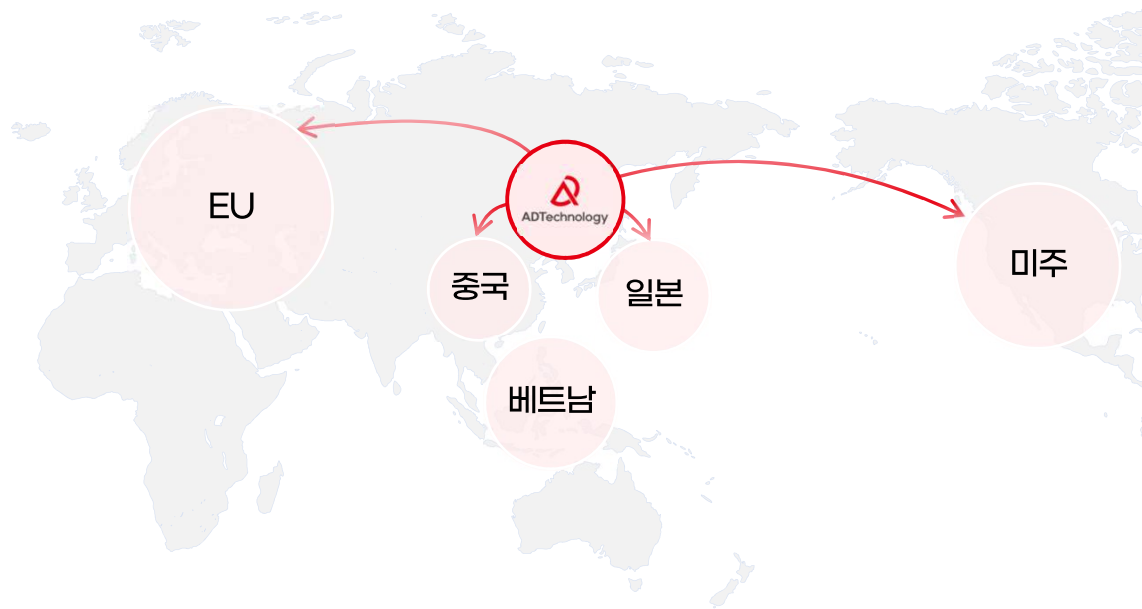
Application	Node	Die Size (mm <sup>2</sup> )	Key Technology	Advanced Packaging
AI/HPC	2nm	700~800	HBM3E, Pcle Gen5	2.5D Packaging
AI/HPC (ADP620)	2nm	300~400	LPDDR5, Ucle	2.5D Packaging
SSD	4nm	100~200	Pcle Gen6	-
Automotive	5nm	100~200	LPDDR5, AI NPU	-
Image Sensor	28nm	100~200	-	3D Packaging

Application	Node	Die Size (mm <sup>2</sup> )	Advanced Packaging
AI/HPC (Datacenter향 가속기용)	4nm	500~600	2.5D Packaging
Network (Datacenter향 Network Switch)	4nm	200~300	-
AI/HPC (Datacenter향 가속기용)	4nm	500~600	3D Packaging

대형 AI/HPC SoC 및 Chiplet 기반 반도체 설계 수행 역량 확보

## 해외 시장 확장

글로벌 고객사와의 협력 확대를 통해 장기적 성장 기반 마련



### 국내 사업장

본사



• 위치: 수원 본사

판교



• 2024년 개설

### 베트남 R&D 센터

베트남 1 캠퍼스



• 자회사 SNST(호치민)

베트남 2 캠퍼스



• 2022년 개설(호치민)

글로벌 R&D 센터  
구축을 통한  
Industry Leading  
개발역량 확보

세일즈 네트워크 강화로  
고객 다변화

### 글로벌 영업 법인



• 2023년 개설



• 2022년 개설

# 2026년 1분기 경영실적

1. 2026년 1분기 경영실적(별도)
2. 2026년 1분기 경영실적(연결)
3. 수주 현황 및 계획



## 2026년 경영실적 (별도기준)

주요 프로젝트 일정 조정(IP 발주 및 Tape Out 지연) 영향으로 1Q 매출 일부 지연되었으나, 이연된 매출은 모두 연내 반영될 것으로 전망

### 경영실적

(단위: 백만원)

구분	'25.1Q	'26.1Q	YoY	'25.4Q	QoQ
매출액	23,987	26,699	11.3%	49,158	(45.7%)
영업이익	183	919	402.2%	4,226	(78.2%)
영업이익률	0.8%	3.4%	2.6%p	8.6%	(5.2%p)
당기순이익	774	1,103	42.5%	(4,757)	흑자전환

### 2026년 1분기 주요 지표

#### AI·HPC·Auto 고부가가치 프로젝트 수주 확대

수주 비중			매출 비중		
'24	'25	'26.1Q	'24	'25	26.1Q
26%	73%	94%	61%	75%	75%

#### 선단공정(5nm 이하) 포트폴리오 확대

수주 비중			매출 비중		
'24	'25	'26.1Q	'24	'25	26.1Q
55%	70%	97%	59%	62%	66%

#### 해외 수주액 성장률

#### 턴키 프로젝트 비중

'25	'26.1Q	수주 비중		
		'24	'25	26.1Q
+134% 성장 (24년 연간대비)	+89% 성장 (25년 연간대비)	60%	81%	96%

## 2026년 1분기 경영실적 (연결기준)

별도 기준 분기 실적 변동성에도 견조한 해외 수주 및 자회사 실적 기여 기반으로 연결 기준 연간 성장 전망 유효

### 경영실적

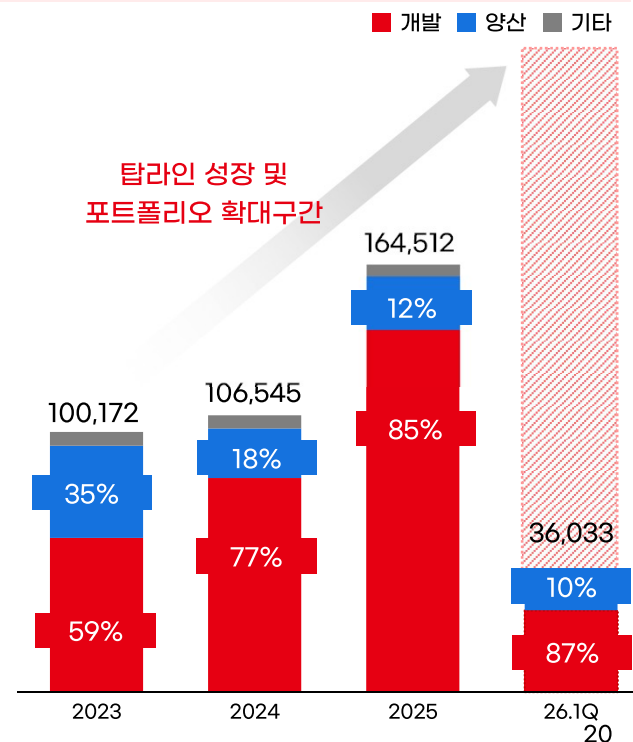
(단위: 백만원)

구분	'25.1Q	'26.1Q	YoY	'25.4Q	QoQ
매출액	32,641	36,033	10.4%	61,038	(41.0%)
영업이익	(1,552)	(357)	-	2,756	적자전환
영업이익률	N/A	N/A	-	4.5%	-
당기순이익	(1,742)	357	흑자전환	5,454	(93.5%)

### 매출액 추이

(단위: 백만원)

삼성전자 DSP 전환 이후, 본격 성장 구간 진입  
→ 글로벌 고객 다변화 및 양산 매출 기반 확장성 기대



## 수주 현황 및 계획: 국내외 고객 수주 확대 및 양산 매출 발생에 따른 이익 레버리지 기대

2026년 매출 성장률 80% 이상 목표

2026년 1분기, 북미 추가 수주 및 일본시장 신규 고객 확보 통한 글로벌 사업 포트폴리오 다변화

지역	2025		2026E		2027E		2028E		2029E		2030E
	하반기	상반기	하반기	상반기	하반기	상반기	하반기	상반기	하반기	상반기	
국내	Automotive향 5nm 고성능 AI 가속기							양산			
	Automotive향 4nm ADAS SoC							양산			
	통신, 네트워크 장비향 14nm SoC			양산							
	통신, 네트워크 장비향 14nm SoC							양산			
	Data Center향 AI 가속기 SoC (E)							양산			
미주	북미 Enterprise Server향 CPU 4nm SoC							양산			
	북미 HPC향 Mining 4nm Soc							양산			
	북미 Data Center향 가속기용 4nm SoC (확정)							양산			
	북미 Enterprise향 Media Processing 4nm SoC (확정)							양산			
	북미 Data Center향 Network Switch 4nm SoC (E)							양산			
	북미 Edge/Sovereign Server향 Network+가속기 2nm SoC (E)							양산			
EU	유럽 Data Center/ Enterprise향 CPU 8nm SoC							양산			
	유럽 Data Center향 가속기용4nm SoC							양산			
	유럽 Edge향 Vision AI 8nm SoC (E)							양산			
	유럽 Data Center향 가속기용 4nm SoC (E)										
	유럽 Enterprise향 보안 Network 4nm SoC (E)							양산			
일본	일본 Data Center향 NIC + Network Switch 4nm SoC (확정)							양산			
양산기대 제품수	'25년	'26년		'27년		'28년		'29년 이후			
	-	1		6		13		16 + α			



**ADTechnology**